

VISUALIZE THE FUTURE



2022年3月期 第1四半期

# 決算補足説明資料

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル

2021年8月11日

本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

会社概要	3
事業内容	4
2022年3月期 第1四半期決算ハイライト	
損益計算書	5
事業別／分野別売上高	6
貸借対照表	7
2022年3月期 第1四半期トピックス	8
2022年3月期 通期業績予想	9
ご参考) 当社4月以降本日までの活動状況	10

創業以来、世界有数のGPU IPベンダーとして実績を誇るファブレス半導体ベンダーです。近年は世界をリードする「AI Computing Company」となるべく、アルゴリズム・ソフトウェアからハードウェア、エッジからクラウドに渡るEnd to EndのAIサービスの提供により、お客様や社会の課題解決に貢献しています。

会社名	株式会社デジタルメディアプロフェッショナル (DMP)
事業内容	GPU及びAIに関わる、IPライセンス、SoC/モジュール開発&販売、及び受託開発サービス
設立	2002年7月
所在地	東京都中野区
代表者	代表取締役会長CEO 山本 達夫 代表取締役社長COO 大澤 剛
資本金	1,838百万円
連結従業員数	65名 (2021年3月末現在)
特許数	49件 (出願中7件)
連結子会社	Digital Media Professionals Vietnam Company Limited

年月	沿革
2002年7月	設立
2005年7月	ULTRAY® ビジュアルプロセッサを発表
2007年4月	PICA®グラフィックスIPコアが「第9回 LSI IPデザインアワード」企業部門「IP優秀賞」を受賞
2009年4月	SMAPH®-FベクターグラフィックスIPコアを発表
2009年11月	SMAPH®-S 3DグラフィックスIPコアを発表
2011年6月	東京証券取引所マザーズ市場へ上場
2014年5月	株式会社UKCホールディングス(現株式会社レスターホールディングス)と業務資本提携
2016年8月	新3DグラフィックスIPコア「M3000」シリーズを発表
2016年11月	Deep Learningを用いた画像認識エンジン「ZIA™」を発表
2018年3月	次世代グラフィックスプロセッサ「RS1」を量産・出荷開始
2019年5月	ヤマハ発動機株式会社と業務資本提携
2019年5月	ISO9001:2015認証(審査機関インターテック・サーティフィケーション株式会社)取得
2020年4月	「Digital Media Professionals Vietnam Company Limited」を設立
2021年4月	米国Cambrian Inc.と資本業務提携

事業	事業内容	主要顧客
IPコア※1 ライセンス事業	<p>精細画像の描画やディープラーニング（深層学習）※2などの人工知能（AI）※3に必要なハードウェアIP（論理設計データ等）やソフトウェアIP（主にハードウェアを制御するドライバーやコンテンツ制作を支援するツール類）の開発、ライセンス（使用許諾）供与</p> <p>a) ライセンス収入：顧客が製品開発を進める過程で、当社がIPコアライセンスのライセンスを与えたことによる対価</p> <p>b) リカーリング収入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ランニングロイヤリティ収入：IP組込み製品を顧客が販売する際、製品出荷個数に応じて顧客から収受する対価</li> <li>・サブスクリプションフィー：当社クラウドサービスの使用実績（PV：ページビュー数）に応じて顧客から収受する対価</li> </ul> <p>c) 保守サービス：保守契約に基づくIPコアの保守等</p>	半導体メーカー 半導体が組み込まれた 最終製品メーカー
製品事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・グラフィックス LSI※4(SoC※5)(主にアミューズメント機器向け)の開発・製造・販売（製造は委託）</li> <li>・AI LSI(FPGA※6)/モジュール(AIを使用する機器向け)の開発・製造・販売（製造は委託）</li> <li>・協働ロボット※7向けビジョンシステム（カメラによる物体認識システム）の販売 等</li> </ul>	商社/SIer 半導体が組み込まれた 最終製品メーカー
プロフェッショナル サービス事業	当社の各種IPコアをインテグレーションしてSoCシステム全体を検討・最適化する設計サービス、自社製品の開発により培ったGPU※8/ビジョン/AI技術等をベースにしたアルゴリズム開発や最適化を行なうソフトウェア/ハードウェアサービス等さまざまなサービスを提供	半導体が組み込まれた 最終製品メーカー

※1: LSIを構成するための部分的な回路情報のうち、特に単一機能でまとめられたもの（例：グラフィックスIPコア）。IPはIntellectual Propertyの略称

※2: 画像認識分野などで実用化が進む、人工知能を実現する機械学習の手法の一種。人間の脳を模したニューラルネットワークの仕組みを活用

※3: 人間が行っている認知や判断を、コンピュータを使って行うためのソフトウェアやシステムのこと。文章、画像、会話、音などを理解し判断するコンピュータプログラムなど

※4: シリコンウエハ（半導体製品の製造に使用される導体と絶縁体の中間の性質を持つ物質）で形成される大規模集積回路。Large Scale Integrationの略称であり、「半導体」とも呼ばれる

※5: 一つの半導体チップ上に必要とされる一連の機能（システム）を集積する集積回路（の設計手法）。System on a Chipの略称

※6: 製造後に購入者や設計者が構成を設定・変更できる集積回路。Field Programmable Gate Arrayの略称

※7: 安全柵なしで人と共同作業ができるロボット

※8: コンピュータゲームに代表されるリアルタイム画像処理に特化した演算装置ないしプロセッサ。Graphics Processing Unitの略称。CPUよりも並列演算性能にすぐれた特性を生かし、その演算資源を画像処理以外の目的に応用する技術（GPGPU: General-Purpose computing on GPU）がAI・ディープラーニング分野に活用されている

## 主にロボティクス分野の活性化により増収

(単位：百万円)	2021年3月期 第1四半期	2022年3月期 第1四半期	増減額
売上高	229	<b>250</b>	<b>+21</b>
営業利益	△114	<b>△95</b>	<b>+18</b>
経常利益	△93	<b>△95</b>	△2
親会社株主に帰属 する四半期純利益	△93	<b>△96</b>	△2

- IPライセンス事業、製品事業の売上高は前年同期とほぼ同等となったが、主にロボティクス分野におけるプロフェッショナルサービス事業の増収により、営業損失は改善
- 前年同期に営業外収益に計上したNEDOプロジェクトに関わる助成金収入21百万円が剥落したため、経常損失、親会社株主に帰属する四半期純損失は前年度比若干悪化

- ロボティクス分野において、PoCや実用段階のビジネス案件が増加
- 安全運転支援分野は、第2四半期以降、新規顧客/プロジェクト向けIPライセンス、プロフェッショナルサービスが活性化見込

## ● 事業別売上高

**IPコアライセンス事業**      **25百万円**      前年同期 28百万円

- デジタル機器向けGPUランニングロイヤリティ、ロボティクス分野向け新規IPライセンス収入、安全運転支援分野におけるリカーリング収益を計上
- GPU関連メンテナンス・サポート収入減

**製品事業**      **171百万円**      前年同期 166百万円

- RS1の量産向けおよびドローン向けカメラモジュールの売上を計上

**プロフェッショナルサービス事業**      **53百万円**      前年同期 34百万円

- NEDO AIエッジコンテストの受託収入剥落も、主にロボティクス分野向けAI受託開発サービスが活発化

## ● 分野別売上高

**安全運転支援分野**      **3百万円**      前年同期 3百万円

- リカーリング収益（ランニングロイヤリティ、サブスクリプションフィー）を計上（2百万円、前年同期実績なし）

**ロボティクス分野**      **57百万円**      前年同期 31百万円

- 新規IPライセンス収入の計上に加え、AI受託開発案件が活発化

**アミューズメント分野**      **171百万円**      前年同期 166百万円

- RS1の量産出荷売上を計上

**その他分野**      **18百万円**      前年同期 28百万円

- デジタル機器向けGPUランニングロイヤリティ収入等を計上したものの、前年同期に計上したNEDOからの受託収入が剥落

## 自己資本比率は92.8%と高水準を維持

(単位：百万円)	2021年 3月末	2021年 6月末	増減額	主な内訳
流動資産	2,736	2,636	△100	売掛金及び契約資産 △77 その他流動資産 △46
固定資産	740	763	+22	投資有価証券 +41 ソフトウェア △13
<b>資産合計</b>	<b>3,477</b>	<b>3,399</b>	<b>△77</b>	
流動負債	208	226	+18	買掛金 +33
固定負債	18	18	+0	
<b>負債合計</b>	<b>227</b>	<b>245</b>	<b>+18</b>	
<b>純資産合計</b>	<b>3,250</b>	<b>3,154</b>	<b>△95</b>	利益剰余金 △96
<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,477</b>	<b>3,399</b>	<b>△77</b>	

## 注力分野における製品・サービス開発、顧客ベース拡大、技術提携等の取り組みを強化・加速

### ロボティクス分野

#### ・「ZIA™ MOVE」をリリース

高精度SLAMソフトウェア「ZIA™ SLAM」を包含し、自動・自律運転に必要な認知・判断・操作機能を完備したロボティックビークル向け統合ソフトウェアプラットフォーム「ZIA™ MOVE」をリリース。ZIA™ SLAM評価キットも提供中

#### ・「ZIA™ Wire」をリリース

ドローン、無人走行ロボット向けに送電線やフェンス等のワイヤーを検出するAI認識モデル「ZIA™ Wire」をリリース



#### ・「ZIA™ ISP」のアップグレード版の提供開始

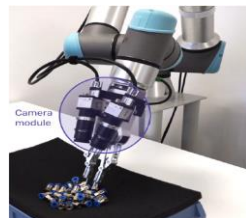
イメージセンサーのHDR（ハイダイナミックレンジ）機能に新たに対応したイメージシグナルプロセッサ(ISP)コア「ZIA™ ISP」の提供を開始

#### ・ヤマハ発動機を始めとしたPoC、実用段階のビジネス案件が活発化

ヤマハ発動機とは、フィールドテストを含めた各種製品へのAI実装で協業中  
その他、PoCを中心に他顧客とのビジネス案件も増加

#### ・Cambrian社のビジョンシステムの拡販開始

資本業務提携先のCambrian社の協働ロボット向けビジョンシステムの拡販を開始。高速認識、高ピッキング成功率、コストパフォーマンスにより、国内シェア拡大を目指す



### 安全運転支援分野

#### ・最新エッジAI認識モデルのデモとベンチマーク向けプラットフォーム「ZIA™ Showcase」を公開

ZIA™ ShowcaseでサポートされたADAS、DMS関連のAI認識モデルと複数のハードウェアにアクセスすることで、顧客自身のデータセットを用いた最適なAI認識モデルとハードウェアの組合せをオンライン、リアルタイムで容易に評価・検証が可能となり、製品開発の効率化に貢献



→ ZIA™ Wireを皮切りにロボティクス分野にも展開中

#### ・新規顧客／既存顧客新規プロジェクトに採用決定

エッジ (ZIA™ SAFE) からクラウド (ZIA™ Cloud SAFE) までの一貫サポートや柔軟な課金モデルの強みを活かし、新規顧客／既存顧客新規プロジェクトに採用決定・内定

#### ・業務用車両の周辺監視用途にZIA™ C3モジュールの継続採用決定

前期採用量産案件の継続採用が決定





アミューズメント市場向け画像処理半導体「RS1」は第1四半期売上実績と大型受注（第2～4四半期に顧客に分納予定）合わせ、11.5億円。期初業績予想に織り込んだ8.4億円を上回る

(単位：百万円)	2021年3月期 実績	2022年3月期 予想
売上高	1,009	1,500
営業利益	△425	△250
経常利益	△361	△250
親会社株主に帰属する 当期純利益	△364	△252

- 第1四半期は主にロボティクス分野活性化により増収、利益（損失）水準は前年同期とほぼ同等
- 第2四半期以降、安全運転支援分野は、新規顧客/プロジェクト向けIPライセンス、プロフェッショナルサービスが活性化見込  
ロボティクス分野では、引き続きPoC、実用段階のビジネス案件増を見込む
- 現段階では5月14日公表の通期連結業績予想に変更なし。RS1の大型受注が連結業績予想に与える影響については精査の上、開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表予定

# ご参考) 当社4月以降本日までの活動状況

各項目は当社ウェブサイトのPR/IRニュースにリンクしています

発表／開催日	内容
2021年4月9日	<a href="#">協働ロボット向けビジョンシステムの開発・販売を行っている米国Cambrian社と資本・業務提携</a>
2021年4月9日	<a href="#">中期事業方向性に関するお知らせ</a>
2021年4月9日	<a href="#">ヤマハ発動機との協業成果としてカメラシステムの外販を開始</a>
2021年4月23日	<a href="#">ZIA™ Showcaseを公開</a>
2021年5月14日	<a href="#">中期経営計画に関するお知らせ</a>
2021年5月14日	<a href="#">ロボティックビークルの自動・自律運转向け統合ソフトウェアプラットフォーム「ZIA™ MOVE」を開発</a>
2021年5月14日	<a href="#">ドローン向けワイヤー検出のAI認識モデル「ZIA™ Wire」を開発</a>
2021年6月23-25日	<a href="#">「INDUSTRY-FRONTIER 2021」リョーサンブースにてDMPの安全監視AI認識ソフトウェアを活用した協働ロボットのデモを展示</a>
2021年6月29日	<a href="#">ソニー製イメージセンサーIMX390のHDR機能に対応したZIA™ ISPの提供開始</a>
2021年6月29日	<a href="#">PALTEK主催ウェビナーにて講演（ロボティクス/自動搬送に適した高精細画像処理KITとAI推論モジュールのご提案）</a>
2021年7月7日	<a href="#">ロボティクス分野でITD Lab社と連携</a>
2021年8月11日	<a href="#">アミューズメント市場向け画像処理半導体「RS1」の大型受注に関するお知らせ</a>

<お問い合わせ先>

株式会社デジタルメディアプロフェッショナル 経営企画部

TEL:03-6454-0450

URL: <https://www.dmprof.com/jp/ir/>

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります。従いまして、実際の業績等が、本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください。